

# 2022年3月期 決算説明資料

---

2022年5月13日



**内外テック株式会社**  
スタンダード3374

# 2022年3月期 連結業績

代表取締役社長 岩井田 克郎

## 2022.3期 業績

■ 売上高	37,551百万円	(前期比 40.5%増)	↑
■ 営業利益	2,121百万円	(前期比 2.0倍)	↑

- 👉 計画を大幅に上回り、3期連続の増収増益  
⇒ロジック・メモリー・パワー半導体投資の増加による好調も、部材調達難により受託製造事業は伸び悩む
- 👉 上場来最高決算を更新

## トピックス

- 内外エレクトロニクス 仙台事業所  
⇒クリーンルーム等の生産設備の増築工事完了（2022年3月）  
⇒中長期的な半導体製造装置の需要拡大に向けた生産体制を強化
- 内外エレクトロニクス 江刺事業所の新築工事着工  
⇒半導体市場の需要拡大に向けた生産キャパシティの拡大
- 内外テック 江刺開発センター準備室開設、及び新築工事着工（上記江刺事業所内）  
⇒高真空/制御技術に対応する開発力強化のため、2023年1月稼働に向けた準備

## 2023.3期 業績予想

■ 売上高	44,000百万円	(前期比 17.2%増)	↑
■ 営業利益	2,360百万円	(前期比 11.2%増)	↑

- 👉 上場来最高決算の更新続く見込み
- 👉 データセンター投資や電気自動車の普及など需要の押し上げ要因により、引き続き成長を見込む

## 予想を上回る大幅な増収増益に 上場来最高決算を更新

(百万円、%)

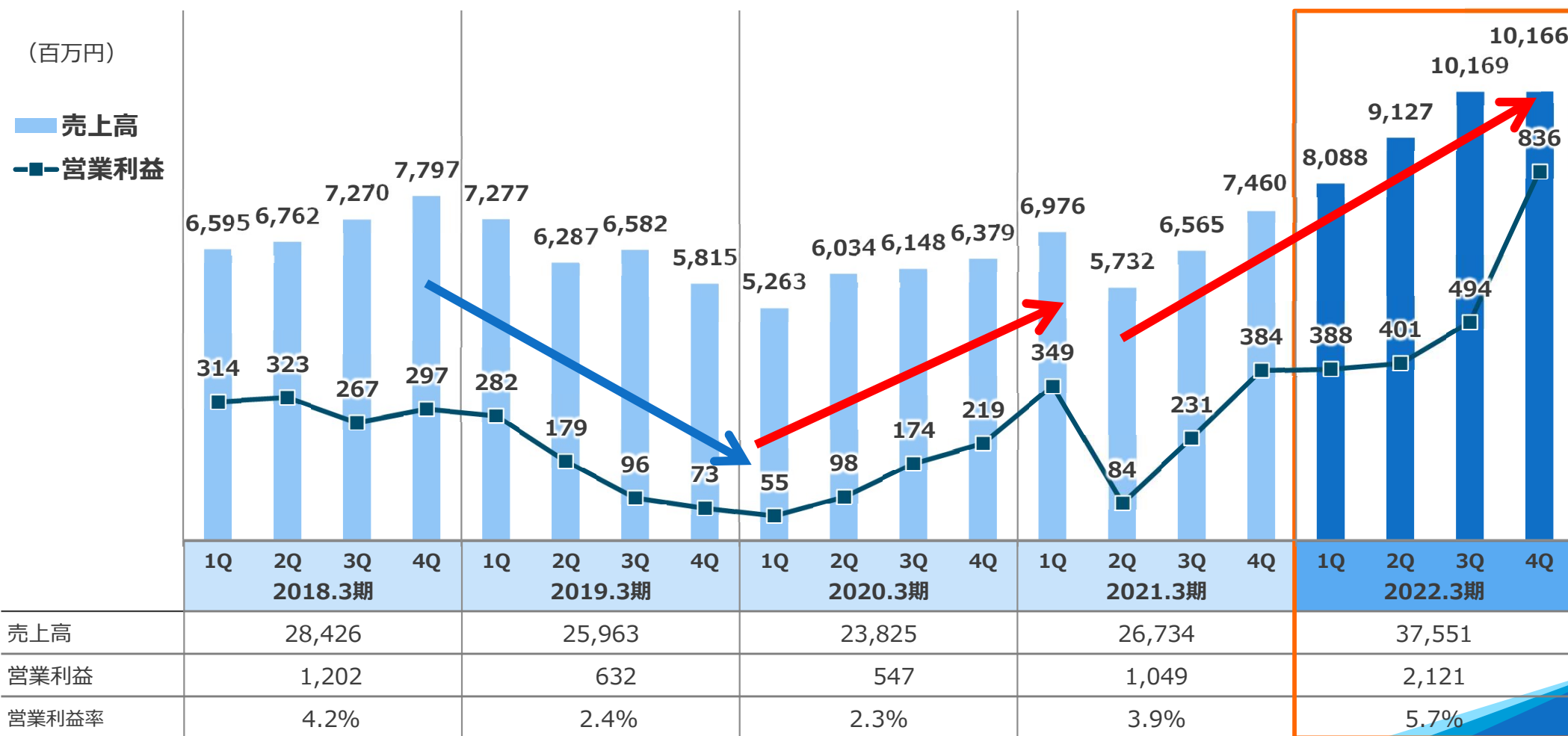
	2021.3期			2022.3期			
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	予想 (11月12日公表)
売上高	26,734	12.2	100.0	<b>37,551</b>	40.5	100.0	35,950
売上原価	23,558	11.2	88.1	<b>33,039</b>	40.2	88.0	-
販管費	2,126	1.7	8.0	<b>2,390</b>	12.4	6.4	-
営業利益	1,049	91.5	3.9	<b>2,121</b>	2.0倍	5.7	1,761
経常利益	1,037	94.3	3.9	<b>2,107</b>	2.0倍	5.6	1,753
親会社株主に帰属する 当期純利益	743	2.2倍	2.8	<b>1,541</b>	2.1倍	4.1	1,146

- 売上高は、高速通信規格（5G）の普及やデータ通信量の増加によるデータセンター投資や車載向けをはじめとする幅広い用途での半導体需要の高まりを背景に、ロジックやメモリー、パワー半導体などの積極的な設備投資が継続したことから大幅な増収。
- 各段階利益は、増収により大幅な増益。
- 税効果会計における繰延税金資産の回収可能性の算出に係る会社分類の見直しにより当期純利益は92百万円増加。

# 売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

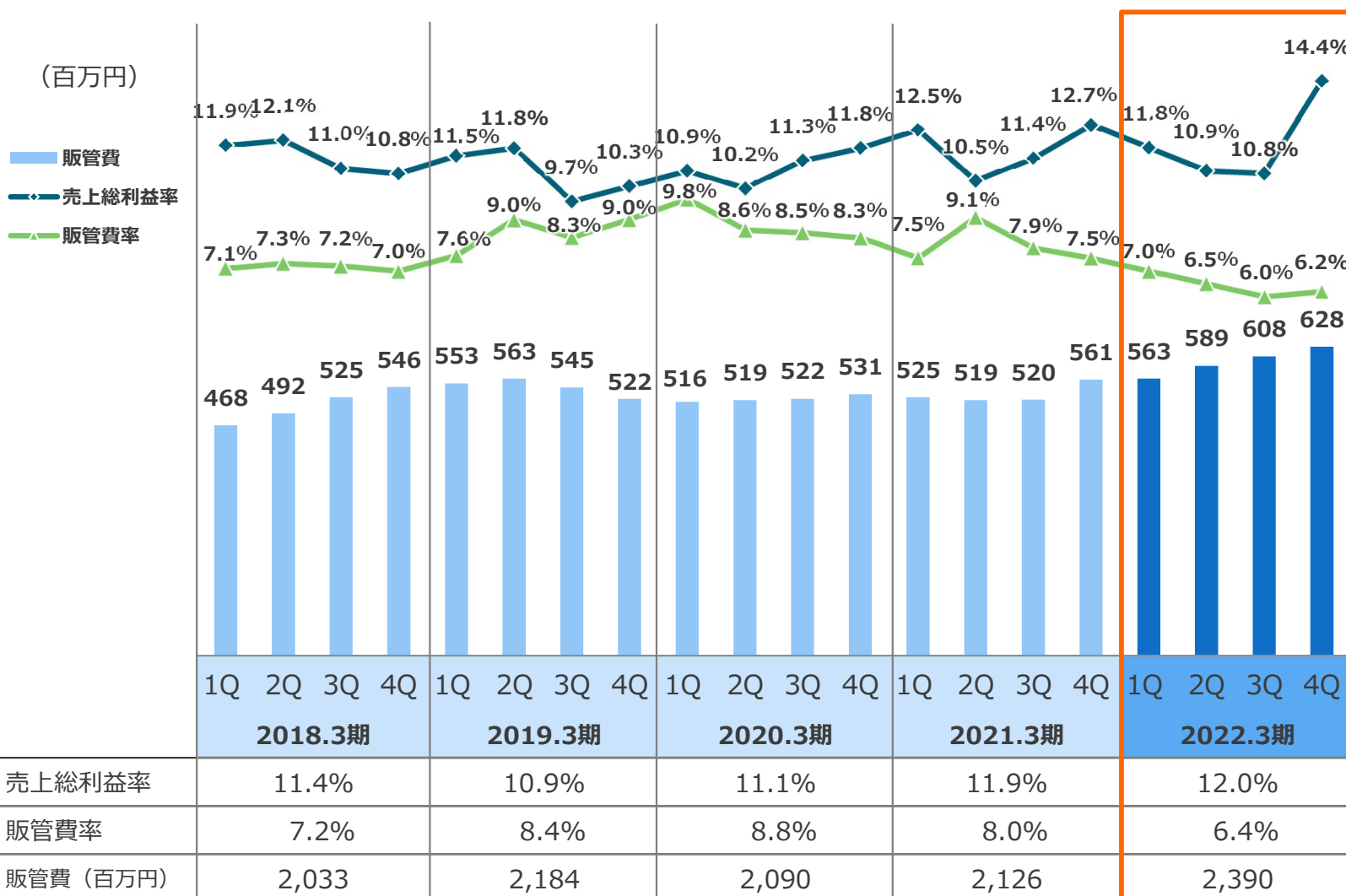
## 売上高・営業利益ともに上場来最高を大幅に更新

- ロジック・メモリー投資とともに堅調に推移し、前2Q以降は増収傾向
- 営業利益は、今後の増産体制に備えた人員確保のための労務費が先行したことから、1Q・2Qは増加幅が鈍化。3Q以降は増収と仕入先からの販売報奨金（4Q）により大幅な増益。



# 売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、先行人員の確保により低下するも、通期では改善  
販管費率は、増収効果により大幅に低下



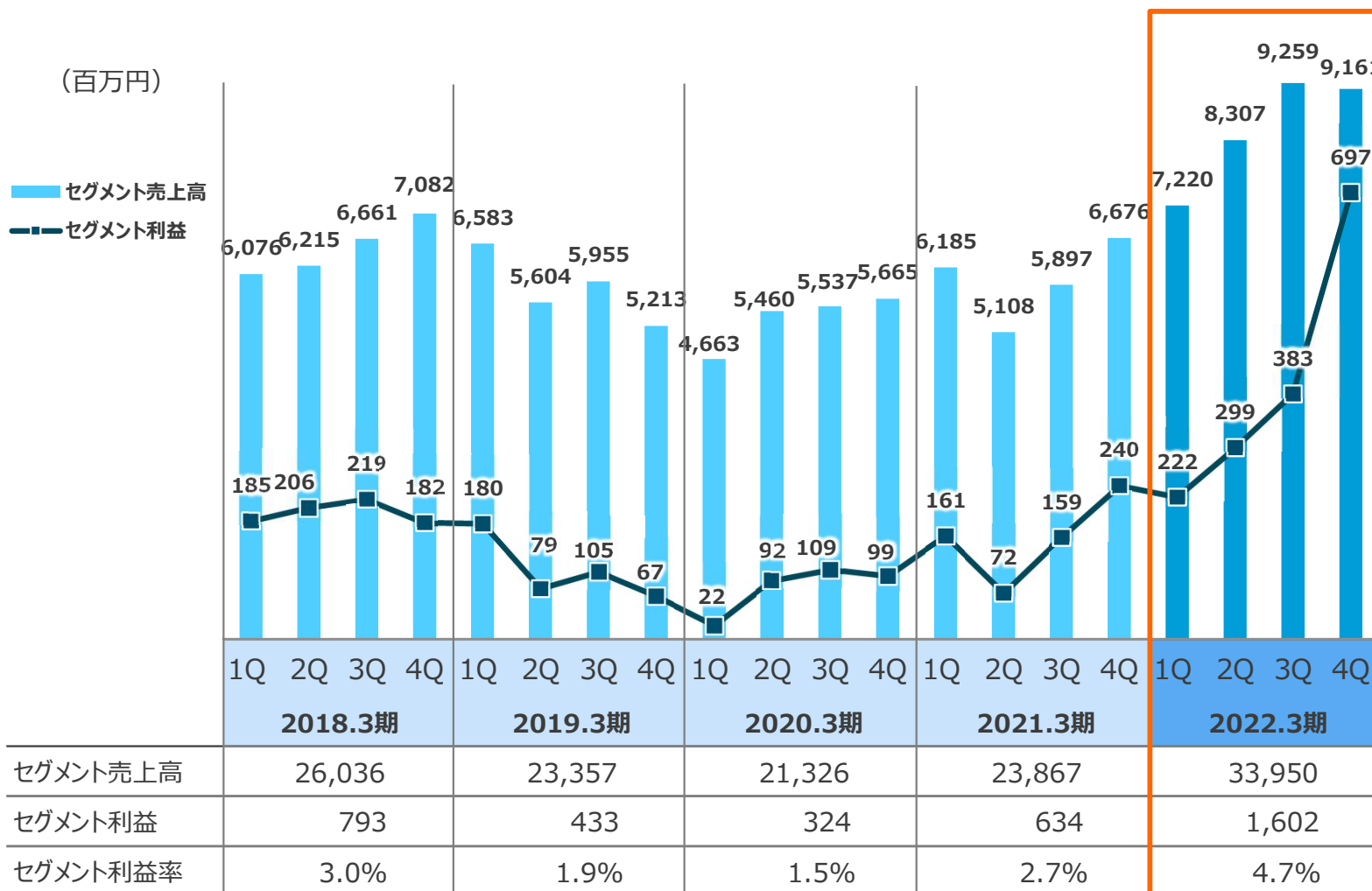
## 売上総利益率

- 今後の成長に向けた人材確保や部材不足による生産効率低下から3Qまでは売上総利益率が低迷。
- 4Qは仕入先からの販売報奨金により大幅に改善。

## 販管費・販管費率

- 販管費は、取扱量の増加に伴い人件費・物流費を中心に増加。
- 増収効果により販管費率は低下。

## 上場来最高の売上高・利益を更新



**セグメント売上高 33,950百万円**  
(前期比 42.2% ↗)

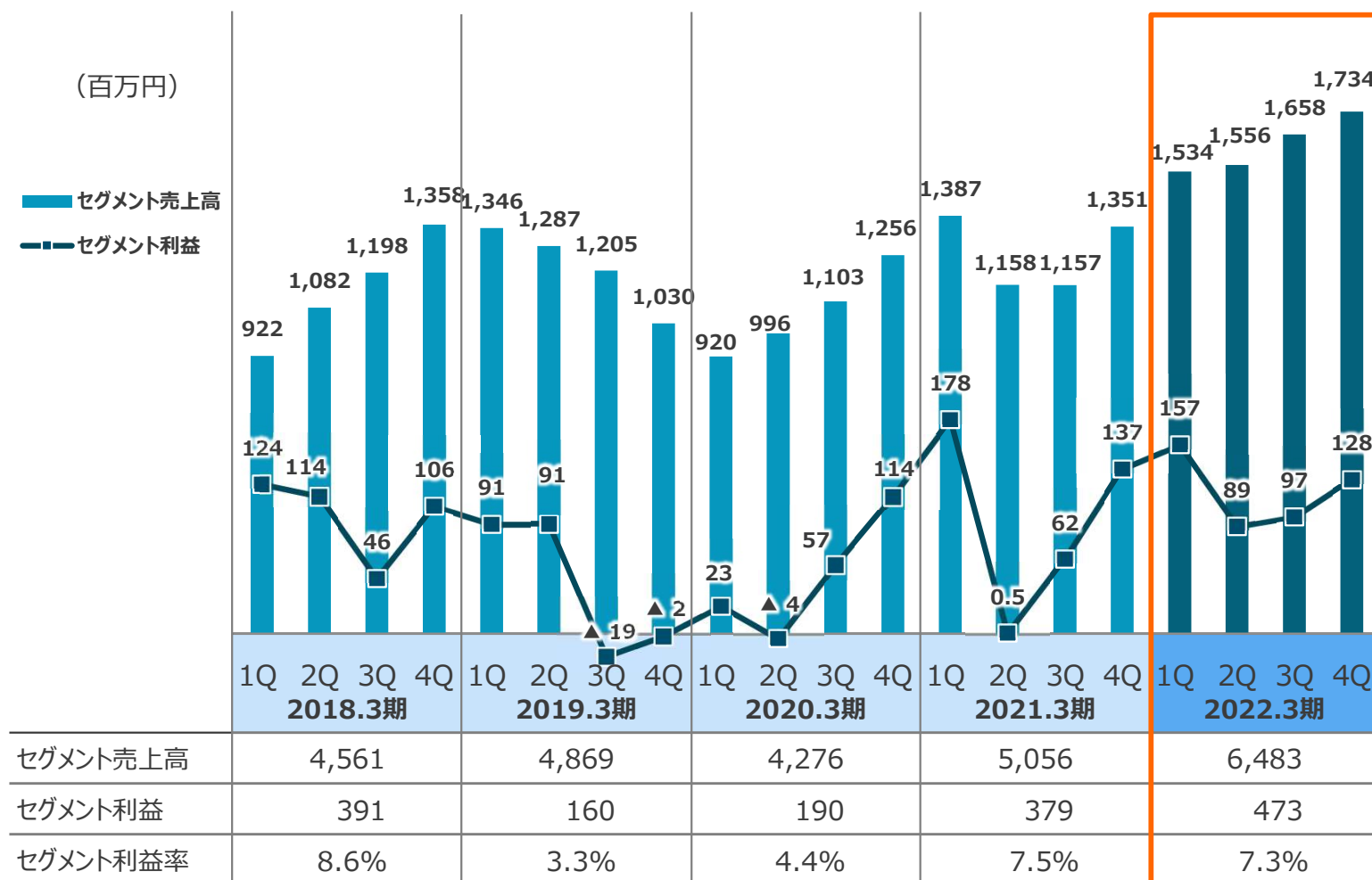
- PCやスマートフォン向けその他、車載向け等半導体需要の活況を受けて、ロジック・メモリー投資ともに拡大し増収。
- 更に、新型コロナウイルス感染症によるサプライチェーンの混乱や世界的な部品不足を懸念した前倒し受注により飛躍的な増収。

**セグメント利益 1,602百万円**  
(前期比 2.5倍 ↗)

- 売上が大幅に増加するも、販管費は一定範囲内で抑制し、大幅な増益。
- 仕入先からの販売報奨金が4Qに寄与。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

## 先行投資負担で利益率はほぼ横ばいながら、 史上最高の売上高・利益を更新



**セグメント売上高 6,483百万円**  
(前期比 28.2% )

- 半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、主要顧客の増産が続き増収傾向。

**セグメント利益 473百万円**  
(前期比 24.8% )

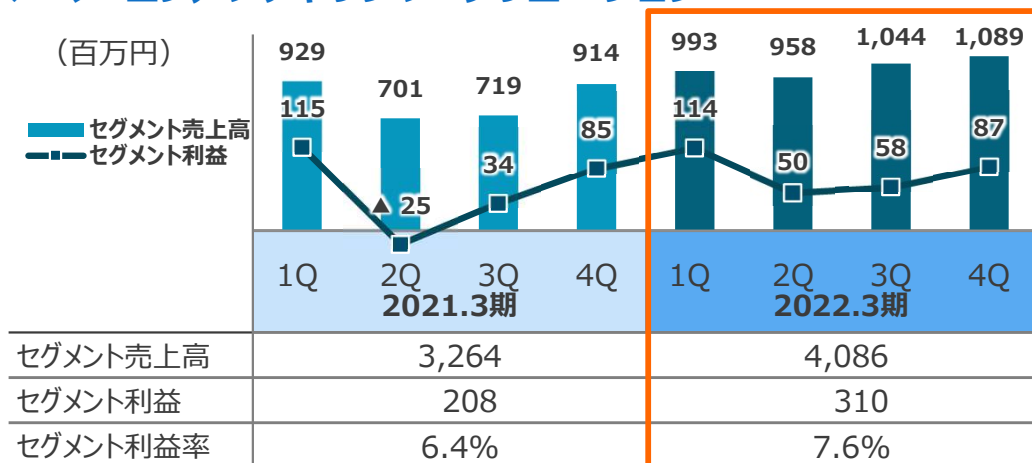
- 今後の増産に備え製造人員の増員を行うも、部材不足から生産性が低下。
- 一部の部材不足による生産性の低下から、その他の部材が滞留。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。



# セグメント情報：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニファクチャリング・ソリューション



### 【事業内容と目的】

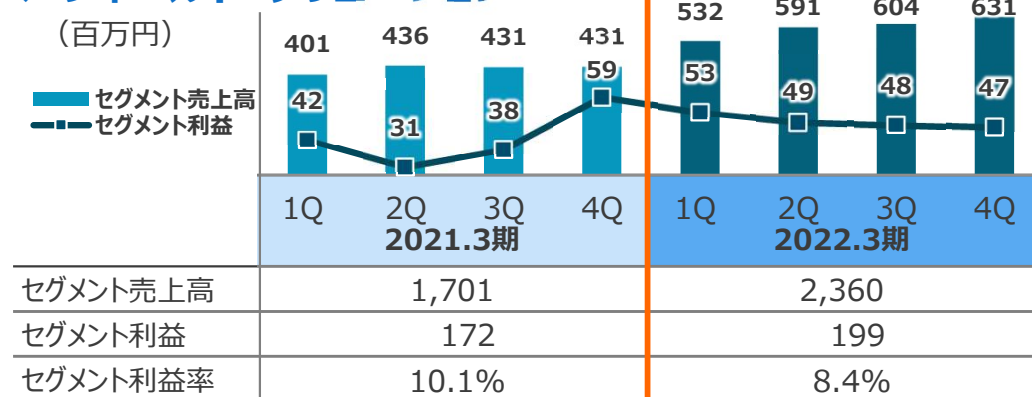
顧客からの受託組立

⇒ 設備投資により市場拡大をキャッチアップ

### 【当期の概況】

- 半導体主要メーカーの投資拡大を受けて、主要顧客の増産が続き受注が増加するも、部材調達の遅れから売上高の伸びは限定的に。
- 計画通りの増産が進まず増員分の労務費が増加するも、利益は大幅に増加。

## ◆ フィールド・ソリューション



### 【事業内容と目的】

保守・メンテナンスサービス

⇒ 保守拠点のカバー地域の拡大により新規獲得

### 【当期の概況】

- 受注が増加するも、部材調達の遅延から計画通りに作業等が進まず。
- 増員分の労務費が増加し利益率は低下するも、増益を確保。

## ◆ テクニカル・ソリューション

		2021.3期				2022.3期			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
四半期ベース	売上高	57	20	6	5	7	5	9	12
	利益	21	▲5	▲9	▲7	▲11	▲11	▲9	▲5
通期	売上高	90				36			
	利益	▲1				▲36			

### 【事業内容と目的】

自社製品開発・技術開発

⇒ 自社開発製品の量産化

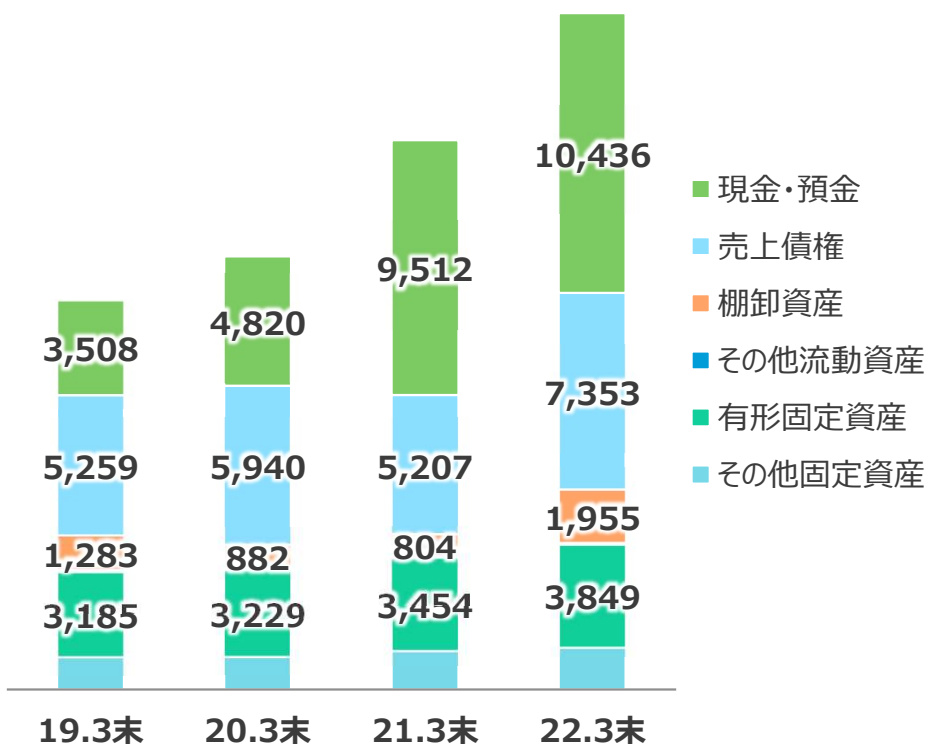
### 【当期の概況】

- 技術研修等、製品開発に必要な技術の習得への投資を強化し、中長期的な成長戦略の中核へ。

# 貸借対照表

## ◆ 資産

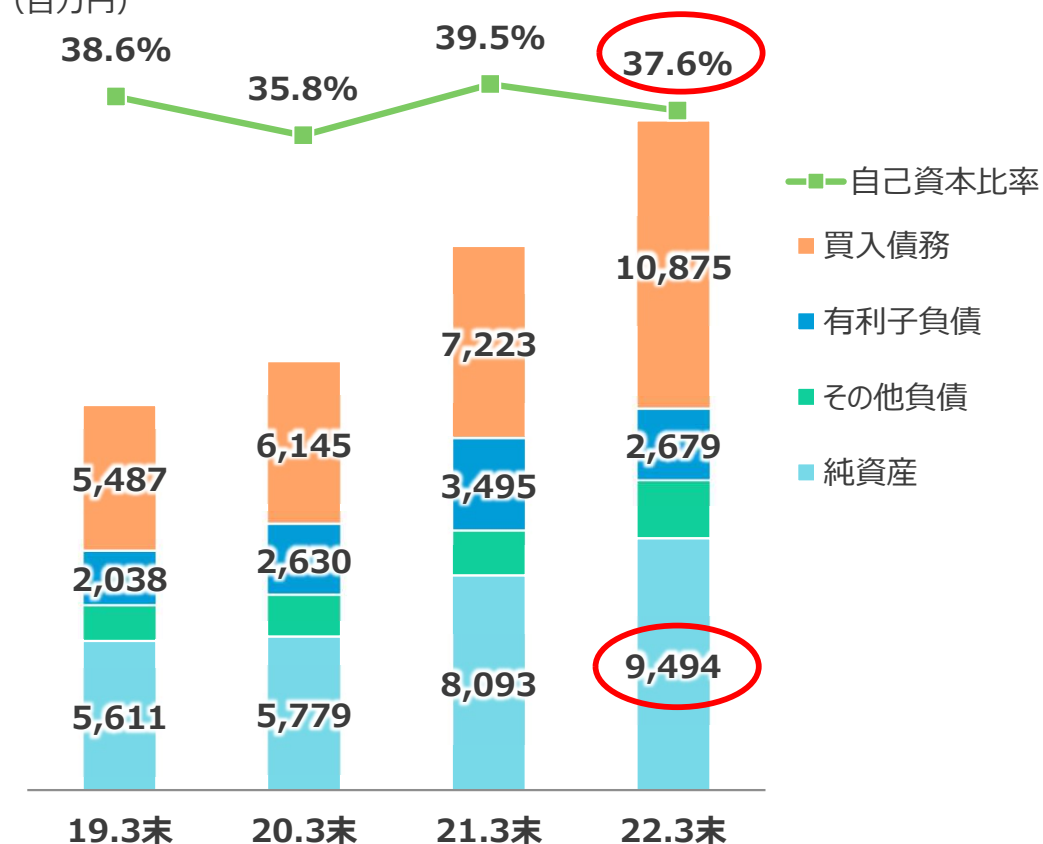
(百万円)



- 売上増加により現預金は9億23百万円、売上債権は21億45百万円増加。
- 部材の調達難やサプライチェーンの混乱に伴うリスク回避のため棚卸資産を積み増し。
- 仙台事業所クリーンルーム増築等の投資により有形固定資産は3億95百万円増加。

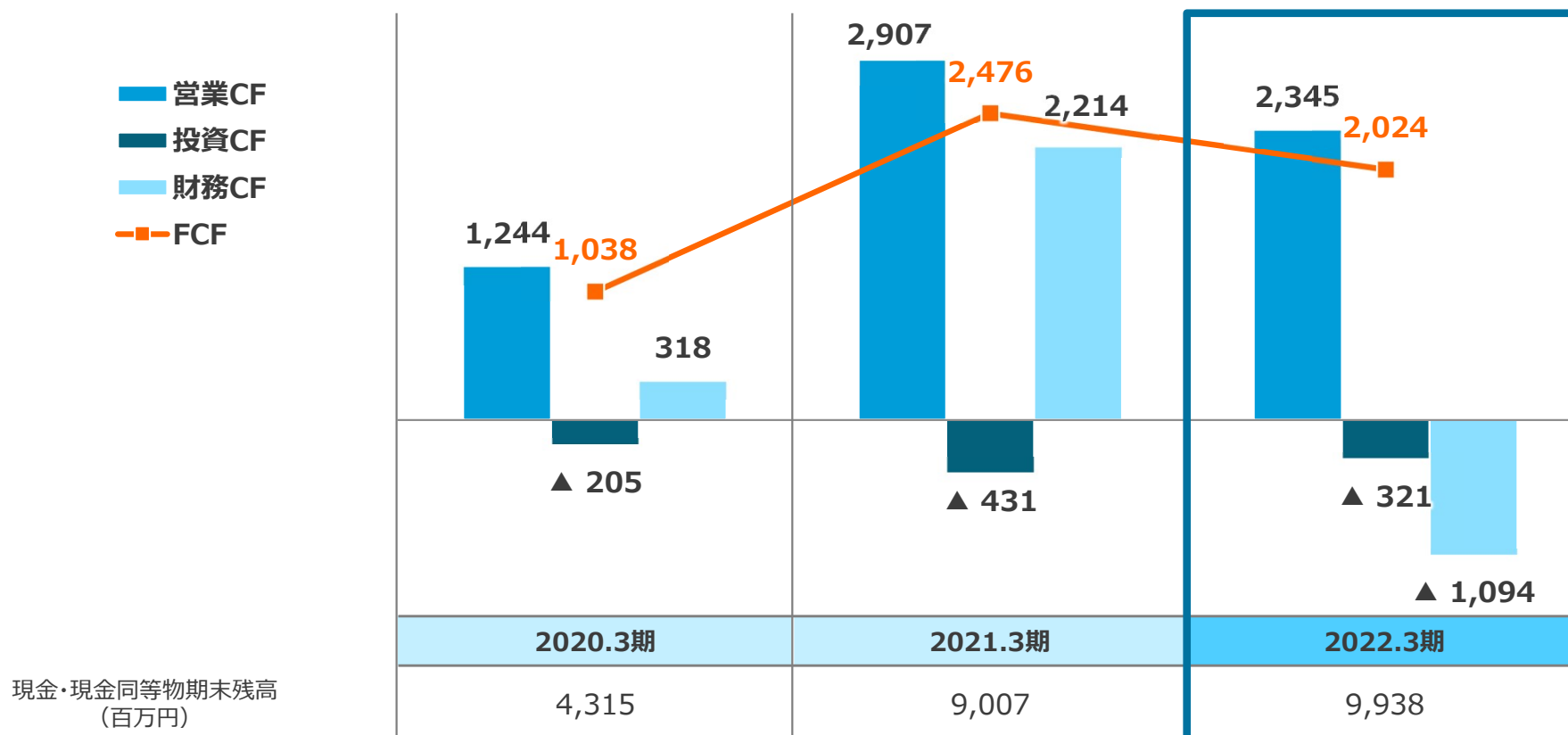
## ◆ 負債・純資産

(百万円)



- 利益の積み上げにより純資産は14億円増加し94億円に。
- 売上増加及び原材料確保のための先行仕入により買入債務が大幅に増加。
- 買入債務の増加による総資本の増加から、一時的に自己資本比率は低下。

## 業績好調によりフリーキャッシュフローは20億円を維持 現金及び現金同等物残高は、9億30百万円増加し、99億円に

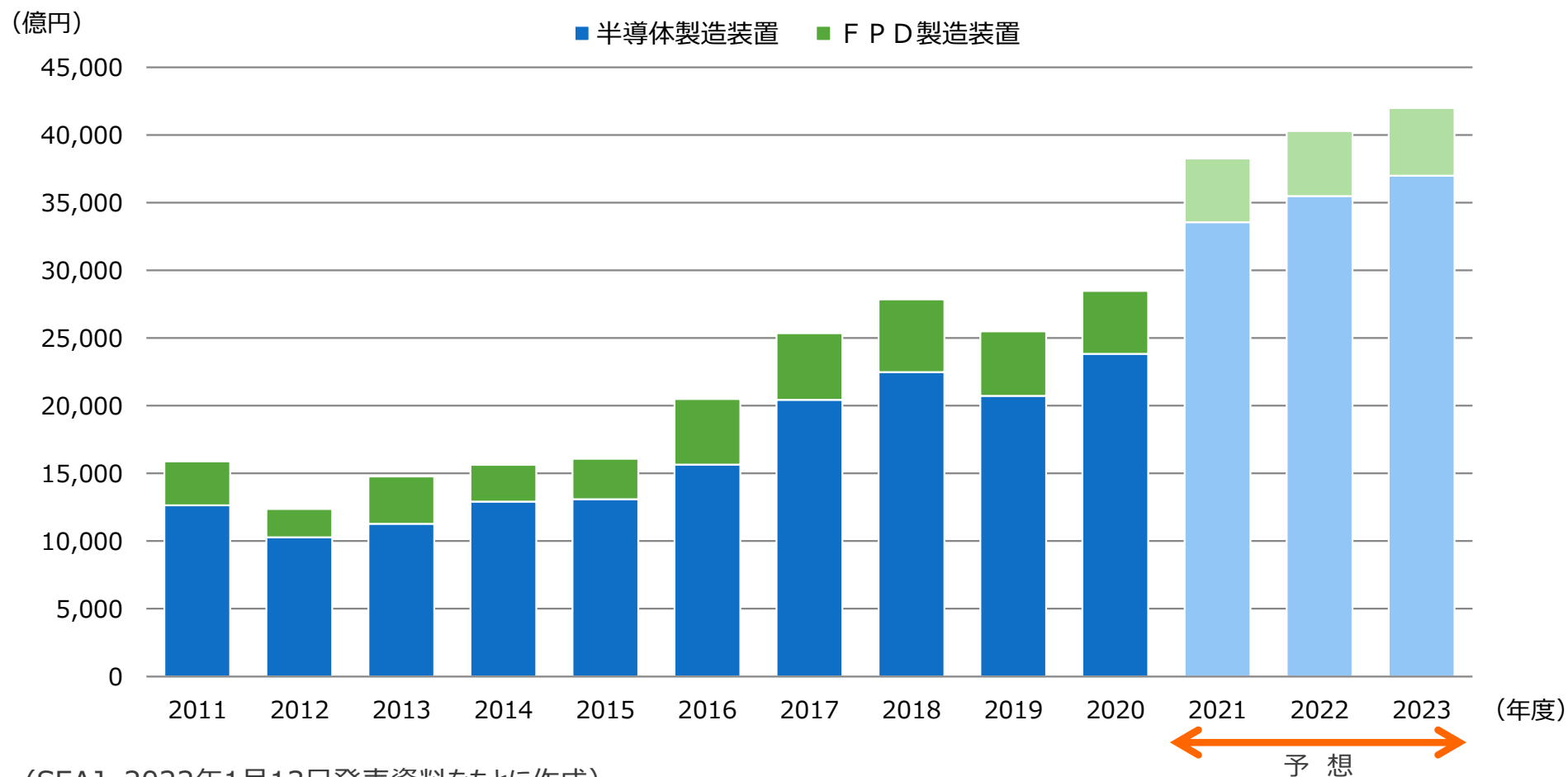


- 営業CFは、税金等調整前当期純利益が大きく増加（前年比10億70百万円）するも棚卸資産の増加額差（12億29百万円）及び売上債権・仕入債務の増減差（4億39百万円）バランス等により、前期比5億62百万円の減少となったが、23億45百万円と引き続き高水準
- 投資CFは、継続設備投資により流出
- 財務CFは、前期に新型コロナウイルス感染症拡大に伴うリスク回避のための先行調達を行ったため、当期の資金調達はなし。返済（8億2百万円）配当金支払（2億15百万円）等により、▲10億94百万円

# 2023年3月期 連結業績予想

## 日本製半導体製造装置販売高は、引き続き拡大傾向を見込む

### 半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



(SEAJ 2022年1月13日発表資料をもとに作成)

## データセンター向けや電気自動車の普及等半導体の需要は、引き続き活況 2023年3月期も増収増益により、上場来最高の更新を見込む

(百万円、%)

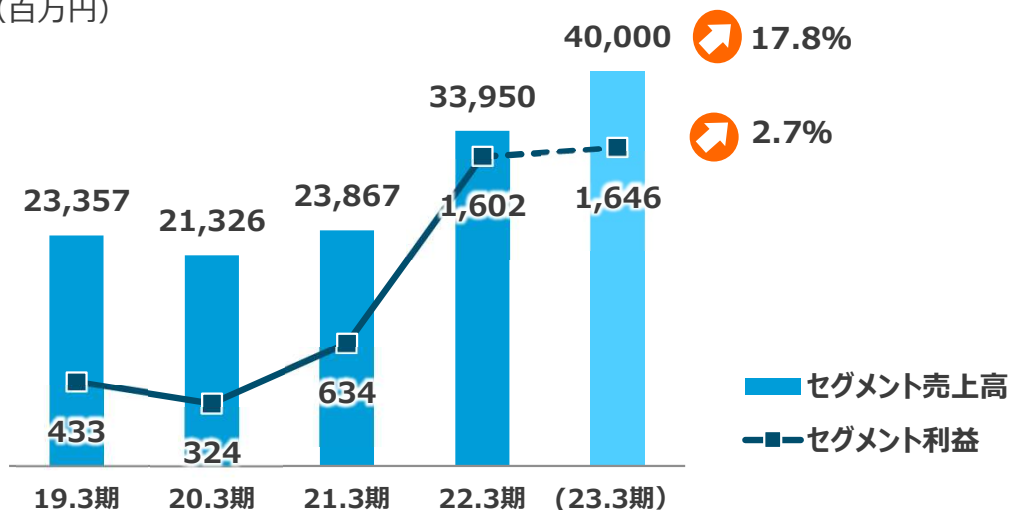
	2022.3期			2023.3期				
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	2Q累計	前年同期比
売上高	37,551	40.5	100.0	44,000	17.2	100.0	20,620	19.8
営業利益	2,121	2.0倍	5.7	2,360	11.2	5.4	1,143	44.6
経常利益	2,107	2.0倍	5.6	2,330	10.5	5.3	1,132	44.8
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,541	2.1倍	4.1	1,580	2.5	3.6	756	43.2

- ※ 2023年3月期の各段階利益には、2022年3月期に計上いたしました仕入先からの販売報奨金は、その額が未定であることから含んでおりません。
- ※ 2023年3月期業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいております。現時点における外部環境は、例年になく、新型コロナウイルス感染症拡大による中国のロックダウン（都市封鎖）やウクライナ情勢等による影響で先行き不透明感が払拭できない状況にあります。引き続き、サプライチェーンの混乱や部品・原材料価格の高騰等による影響について今後も注視するとともに、対策について常に先行していくことが重要と考えております。

# セグメント予想

## ◆ 販売事業

(百万円)



### セグメント売上高

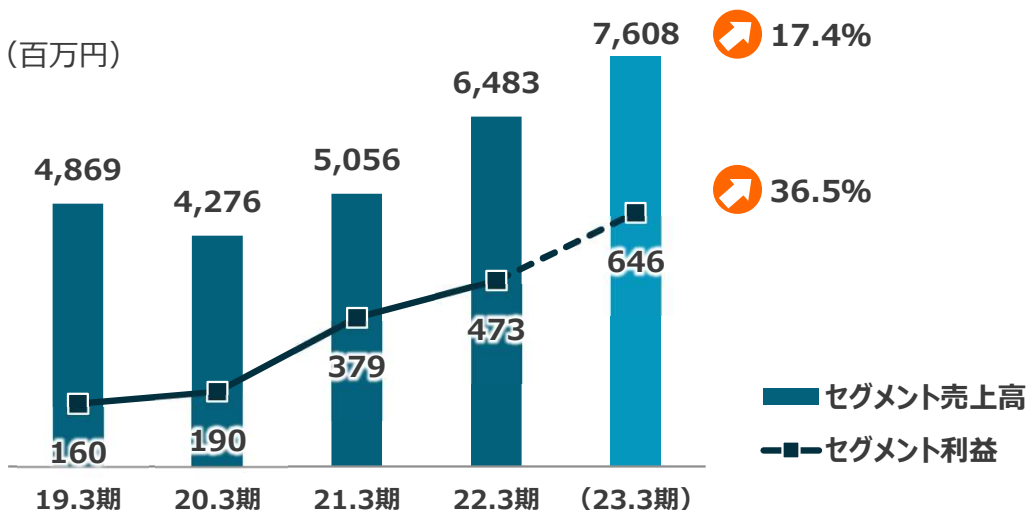
- 先期から続く旺盛な半導体需要を背景に、ロジック・メモリー投資拡大を見込み、大幅な増収を予想。

### セグメント利益

- 人材開発における採用・教育等の人件費及びグループの物流統合による物流費等が増加するも、売上増加や業務効率化により増益を見込む。

## ◆ 受託製造事業

(百万円)



### セグメント売上高

- 主要顧客からの堅調な受注により増加傾向。
- 仙台事業所の生産設備増設によりキャパが増加し、売上への貢献を見込む。

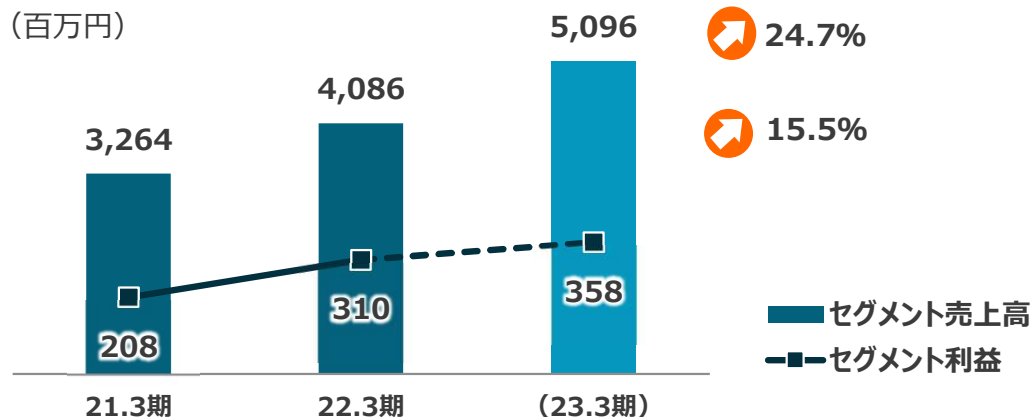
### セグメント利益

- 損益分岐点操業度の改善や合理化による収益改善を見込む。

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

# セグメント予想：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニュファクチャリング・ソリューション



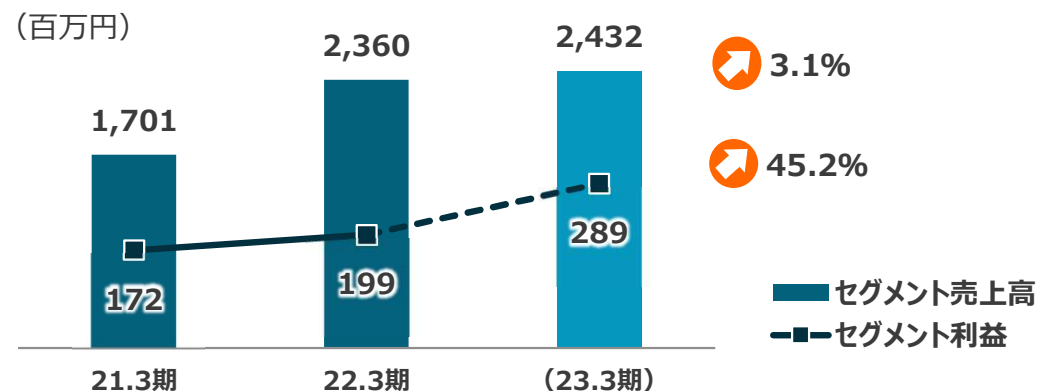
### セグメント売上高

- 主要顧客からの堅調な受注により着実な増加を見込む。
- 仙台事業所の生産設備増設が寄与。

### セグメント利益

- 増収による利益の増加。
- 損益分岐点操業度の改善や合理化による収益改善を推進。

## ◆ フィールド・ソリューション



### セグメント売上高

- 保守体制の強化により売上への貢献を見込む。
- 仙台事業所の生産設備増設も寄与。

### セグメント利益

- 増収による利益の増加。
- 損益分岐点操業度の改善や合理化による収益改善を見込む。

## ◆ テクニカル・ソリューション

	21.3期	22.3期	(23.3期)
セグメント売上高	90	36	80
セグメント利益	▲1	▲36	▲1

### セグメント売上高

- 高真空機器における新たな製造技術を要する製品へ取組。

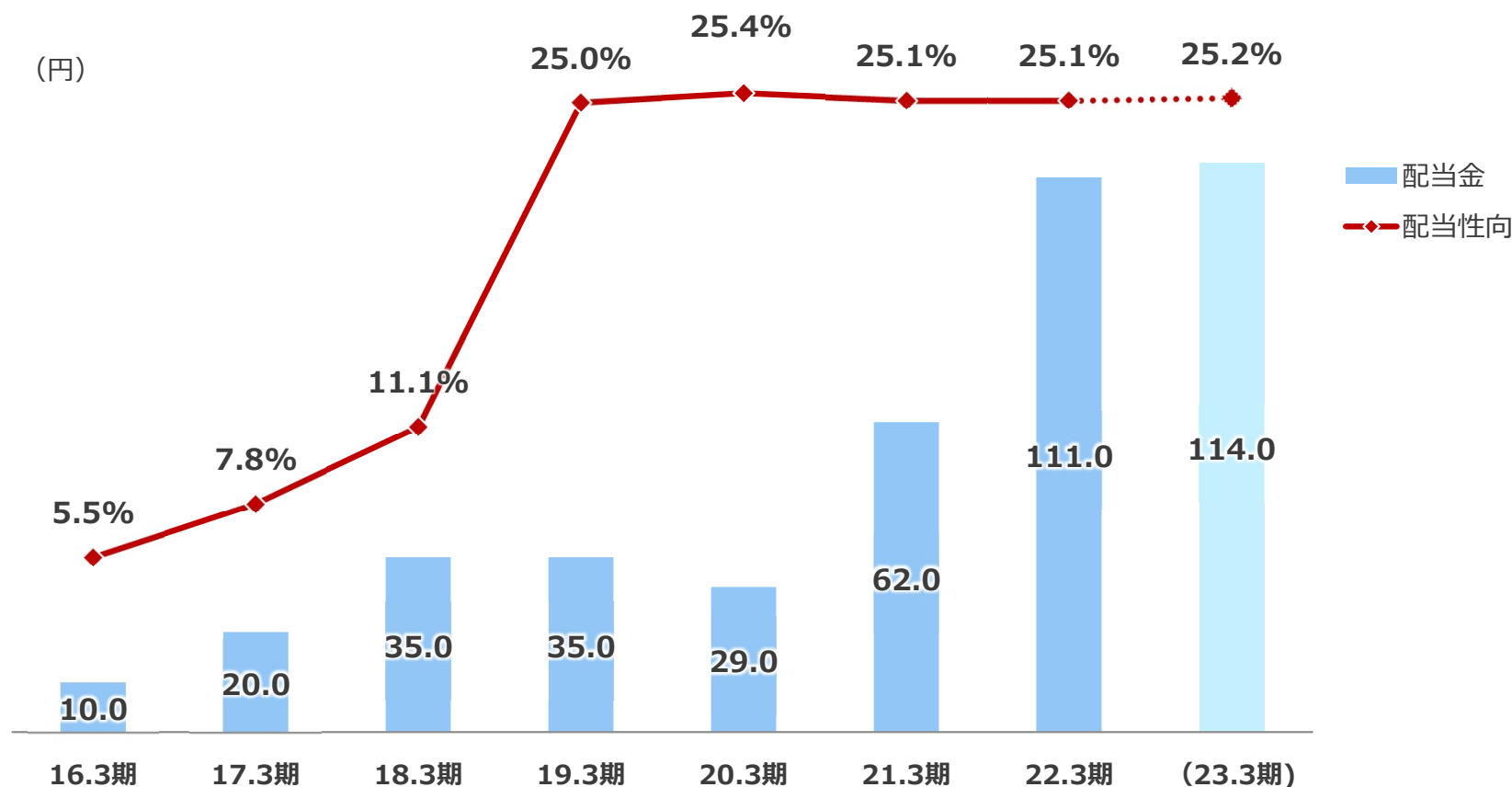
### セグメント利益

- 製造技術と生産の工夫・改善により収益改善を見込む。



## 連結配当性向25%程度を基準

- 2022年3月期の配当金は、予想を上回り上場来最高
- 2023年3月期の配当予想は、上場来最高の更新を見込む

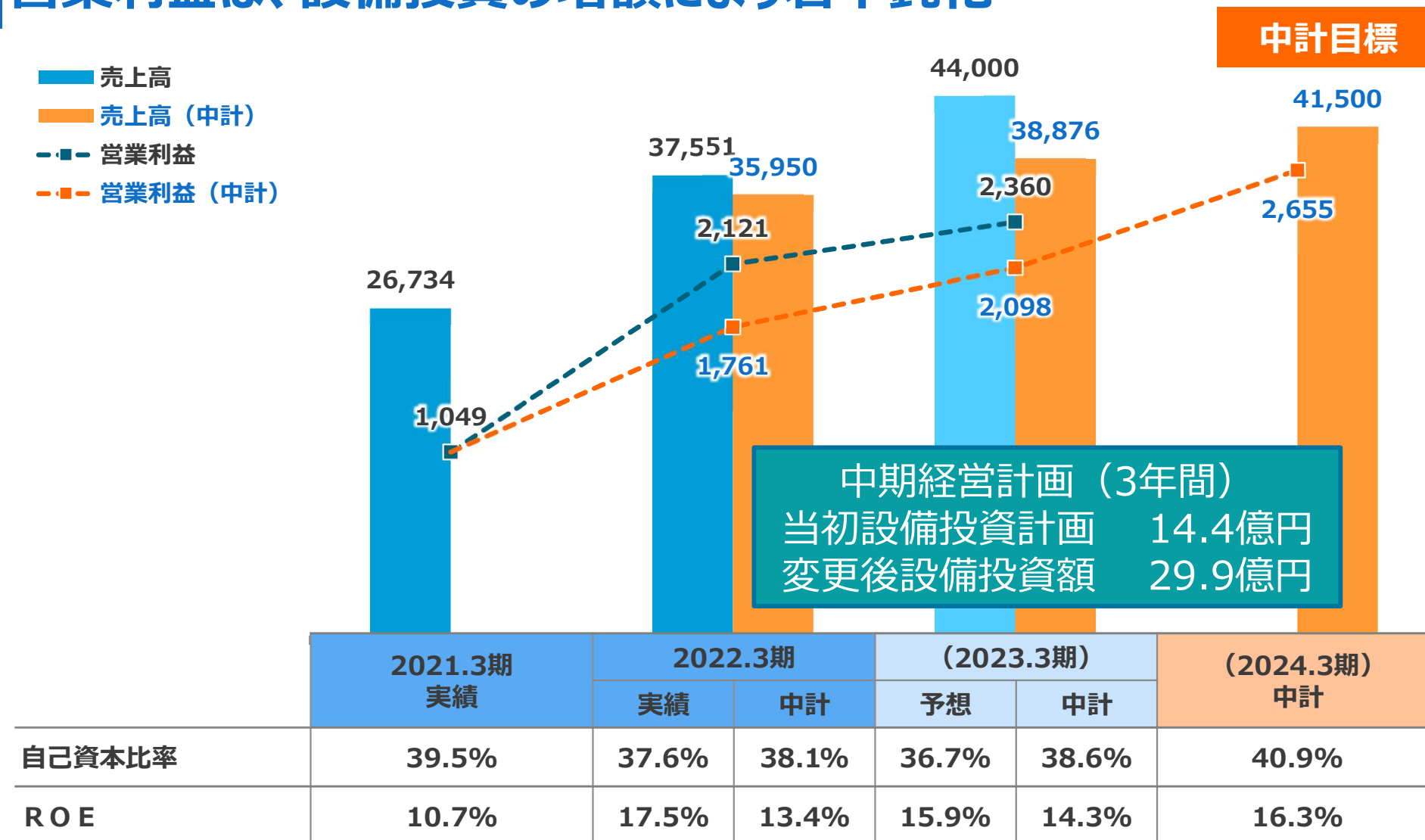


(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

# 中期経営計画の進捗状況

代表取締役会長 権田 浩一

## 中計目標の売上高は1年前倒しで達成見込み 営業利益は、設備投資の増額により若干鈍化

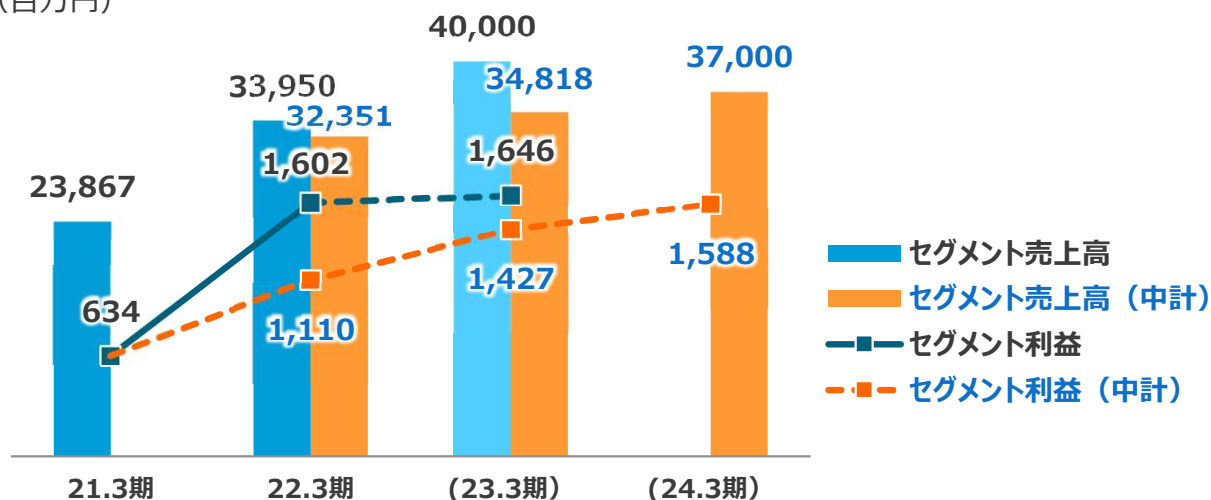


# セグメント予想

## ◆ 販売事業

(百万円)

中計目標



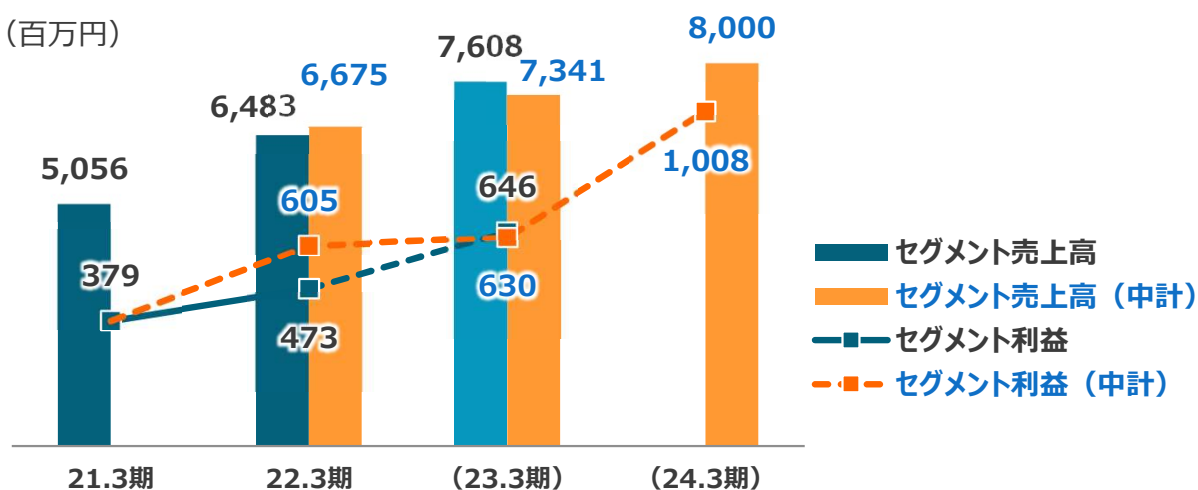
● 販売事業は、23.3期に売上高・利益ともに24.3期中計目標達成の見込み。

- 顧客からの受注残は依然増加傾向
- 仕入先からの販売報奨金等は今期以降の予想に含めず。(合理的に見積もれないため)
- 顧客の納期対応に万全を期すため、更に在庫を積み増し
- グループ内の物流を順次統合し、合理化によりコストアップ要因を吸収

## ◆ 受託製造事業

(百万円)

中計目標



● 受託製造事業は、ほぼ計画通りの達成見込み。

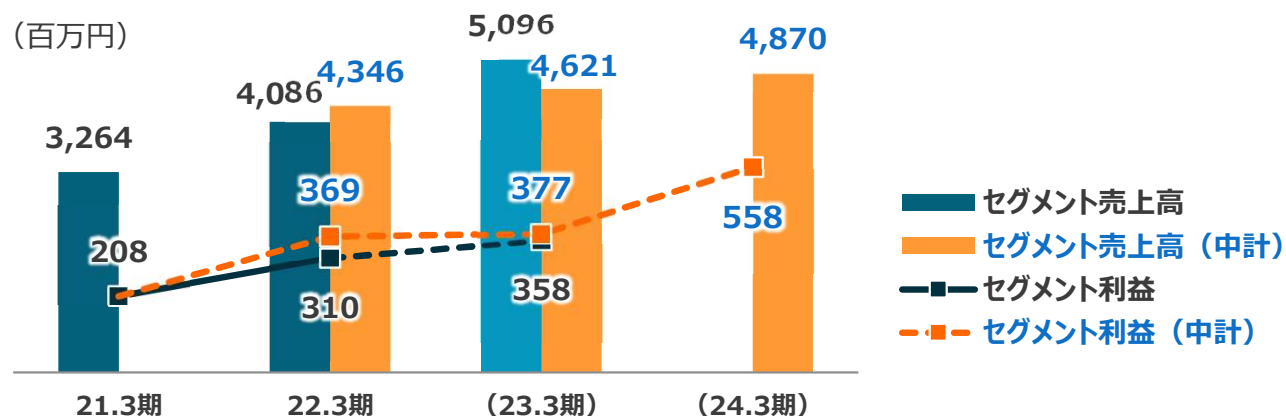
- 最大のリスク要因は部品の納期遅れ
- 部品の納期遅れによる生産効率低下はあるが、人員に関しては継続的に増員方針
- 人材の採用難はあるが、技術者の採用は全国規模で積極展開
- 仕掛品を減少させるため、製造リードタイムと部品納期のマネジメントを更に強化

(注) セグメント売上高は、連結調整前の数値となっています。  
セグメント利益は、連結営業利益の調整額前の数値となっています。

# セグメント予想：受託製造事業のサブ・ポートフォリオ

## ◆ マニファクチャリング・ソリューション

(百万円)

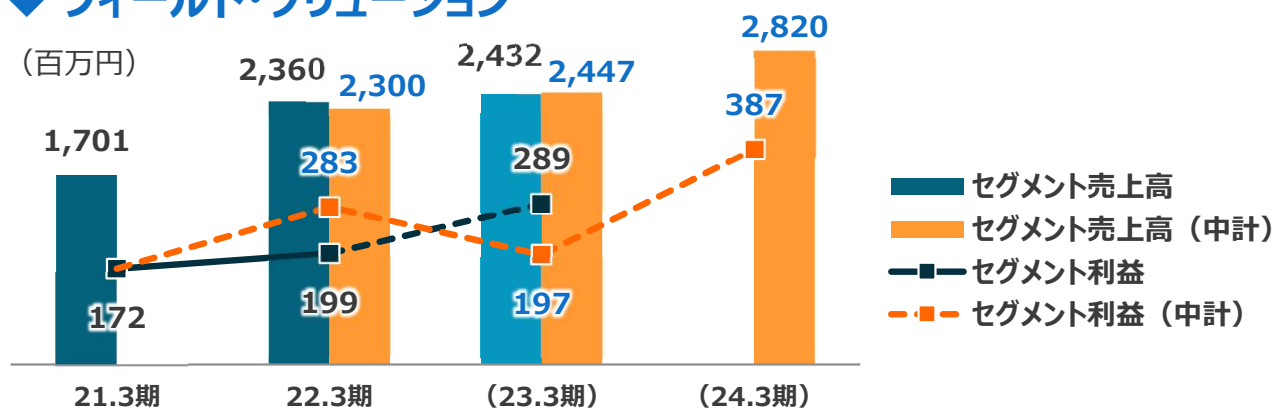


- マニファクチャリング・ソリューションは、部品の納期遅延の影響を見込む。

- ・ 原価の改善や業務の合理化を推進し、利益率の向上を目指す。
- ・ 江刺事業所の22/12完成により4Qより生産に寄与
- ・ 23.3月期の上期中に部品納期の正常化を見込む

## ◆ フィールド・ソリューション

(百万円)



- フィールド・ソリューションは、保守エリア拡大や新規顧客獲得等により、中期計画達成を見込む。

- ・ 当初の中期計画では江刺事業所の立上費用を23.3期に見込むが、装置組立増産・開発体制の強化を優先し、設備投資内容を変更。
- ・ 人員の採用・育成がリスク要因

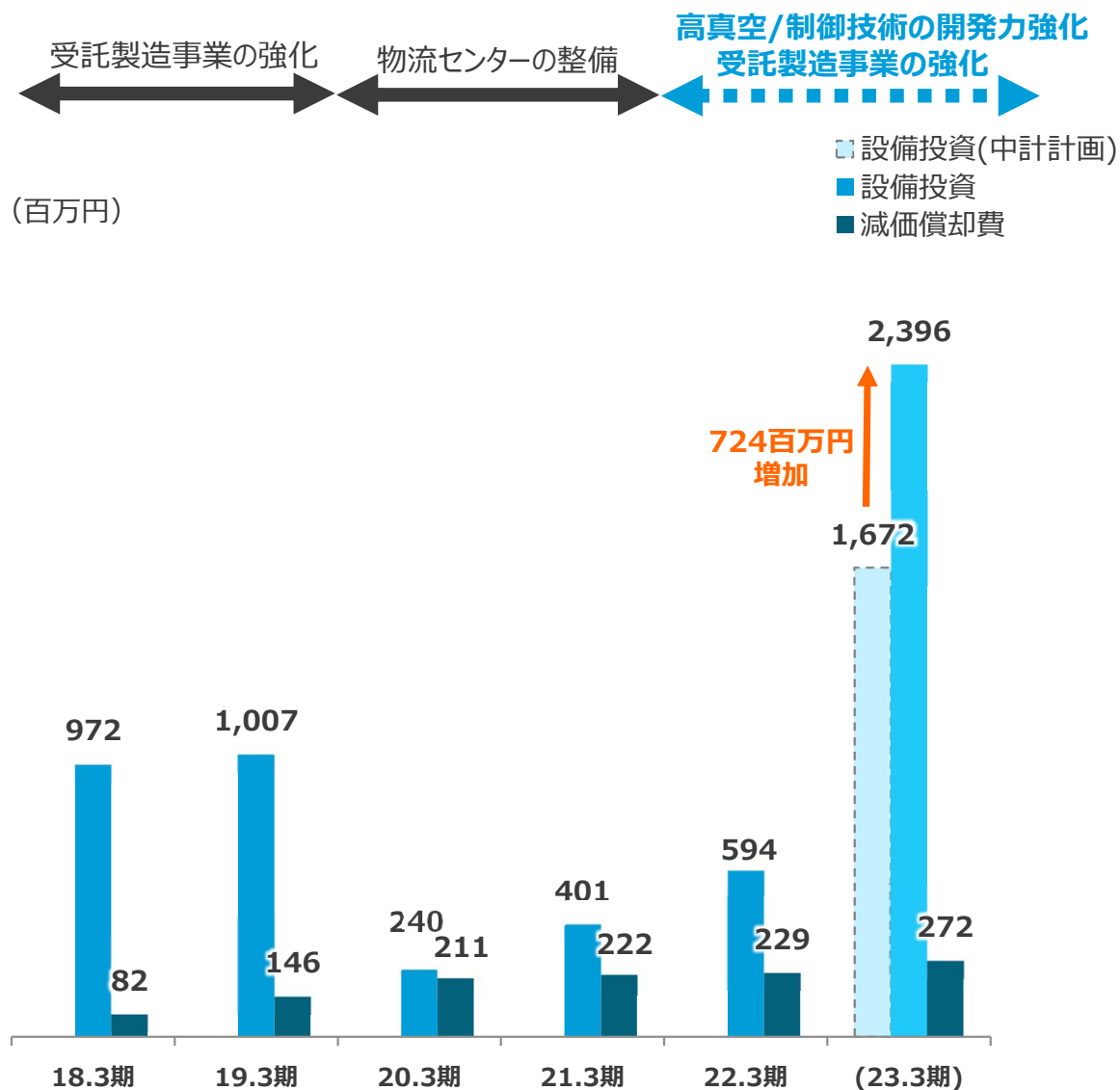
## ◆ テクニカル・ソリューション

	21.3期	22.3期		(23.3期)		(24.3期)
	実績	実績	中計	計画	中計	中計
セグメント売上高	90	36	29	80	271	310
セグメント利益	▲1	▲36	▲47	▲1	54	62

- テクニカル・ソリューションは、今後の成長を見据えた製品の受注と製造技術やスキルの向上に注力

- ・ 新規の半導体製造装置に採用されるモジュールを開発
- ・ 各仕入先とも協業

## 今後の成長を加速させるため、当初計画を上回る設備投資へ



### 主要設備投資の目的

1. 販売事業の倉庫・物流体制強化
2. 受託製造事業の生産能力拡大
3. 仕入先メーカーとの協業による開発体制の強化

#### ● 21/3期

- ・内外テック 宮城物流センター  
新棟増築 3.2億円

#### ● 22/3期

- ・内外テック 宮城物流センター  
グループ物流の統合 1.4億円
- ・内外エレクトロニクス 仙台事業所  
クリーンルーム改築 3.2億円

#### ● 23/3期予定

- ・内外エレクトロニクス 江刺事業所  
工場新設 23.5億円
- ・内外テック  
内外エレクトロニクス江刺事業所内に  
自社開発のための開発センターを新設

## 製品開発力・生産能力の更なる強化のために、計画を上方修正

- 半導体市場の需要拡大への生産対応、及び顧客からのより高機能・高性能の要求が高まる高真空／制御技術に対応する開発力強化のため、江刺事業所に集約し投資を更に拡大

前回変更（11月12日公表）

変更後

内外テック 宮城物流センター グループ物流の統合	2021年 11月 竣工予定	1.7億円	内外テック 宮城物流センター グループ物流の統合	2021年 11月 竣工	1.4億円
内外エレクトロニクス 仙台事業所 クリーンルーム改築	2022年 2月 竣工予定	3.3億円	内外エレクトロニクス 仙台事業所 クリーンルーム改築	2022年 3月 竣工	3.2億円
内外エレクトロニクス 奥州事業所 第二工場新設  内外テック 奥州開発センター	2022年 10月 竣工予定	19.3億円	内外エレクトロニクス 江刺事業所 工場新設  内外テック 江刺開発センター	2022年 12月 竣工予定	23.5億円
内外テック 入江工研株式会社との 資本提携	2021年 3月 実施済	0.5億円			
内外エレクトロニクス 福島事業所 工場増築	2022年 10月 竣工予定	2.1億円			



内外エレクトロニクス  
江刺事業所  
土地：8,666㎡  
延床面積：6,927㎡

# サステナビリティ目標の進捗状況

マテリアリティ	カテゴリー	サステナビリティ目標	サステナビリティKPI	単位	22.3期				23.3期
					目標	実績	目標比	評価	目標
顧客対応力	商社機能	サプライチェーンの最適化	物流コストの削減率（21/3期比）	%	▲ 5	▲ 10	▲ 5	○	▲ 10
		顧客情報の情報セキュリティ	情報セキュリティに関するクレーム件数	件	0	0	0	○	0
生産性向上	製造機能	製造部門の効率化	製品品質クレーム数の削減（前年対比）	%	▲ 10	38	48	▲	▲ 10
		高真空分野の製品量産	量産移行件数（21/3期比）	件	5	33	28	○	10
保守・メンテナンス	保守・メンテナンス機能	中古機部門の技術革新	修理リードタイムの低減（21/3期比）	%	▲ 10	1	11	▲	▲ 10
		リペア部門の一元管理化	保守管理リードタイムの低減（21/3期比）	%	▲ 5	0	5	▲	▲ 5
製品開発力	R&D機能	高真空分野の製品開発	製品開発数	件	0	1	1	○	0
経営基盤	経営管理	環境コンプライアンス	環境マネジメント（ISO14001）の維持審査合格	認証	認証	認証	0	○	認証
		有害物質管理	有害物質含有調査率（回答率）	%	100	100	0	○	100
		CO2 排出量削減効果	CO2 排出量削減	%	-	▲ 2	-	-	-
		労働安全衛生	重大事故（休業災害）発生件数	件	0	0	0	○	0
		中核人材における多様性	女性管理者比率（グループ）	%	5	5	0	○	6
		教育機会の付与	一人あたりの研修時間	時間	5	21	16	○	5
		コンプライアンス・腐敗防止	重大なコンプライアンス違反（訴訟）件数	件	0	0	0	○	0
		責任ある鉱物調達	紛争鉱物調査率（回答率）	%	100	98	▲ 2	▲	100
		DXの推進・情報管理	デジタル化による業務効率向上（21/3期比）	%	10	11	1	○	20
		責任ある情報管理体制	機密情報の流出件数	件	0	0	0	○	0
		継続的成長を実現する財務基盤の強化	自己資本比率	%	38.1	37.6	▲ 0.5	▲	38.6

※ ○ = 達成 ▲ = 未達成



# **(参考資料)**

## **会社概要**

# 会社概要

所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 625名 (2022年3月末)
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材 (上海) 商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○  
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

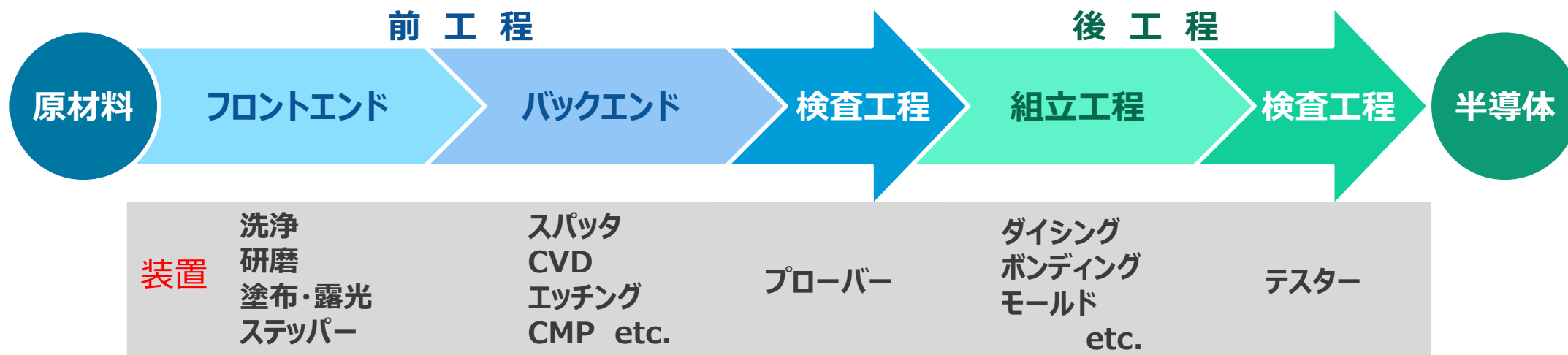
中国・上海



納宜伽機材 (上海)



## 半導体製造工程概要



5G対応のスマートフォンや基地局向け、自動車の自動運転向けなど半導体の需要増を背景に、前工程装置の設備投資の再拡大が見込まれる。

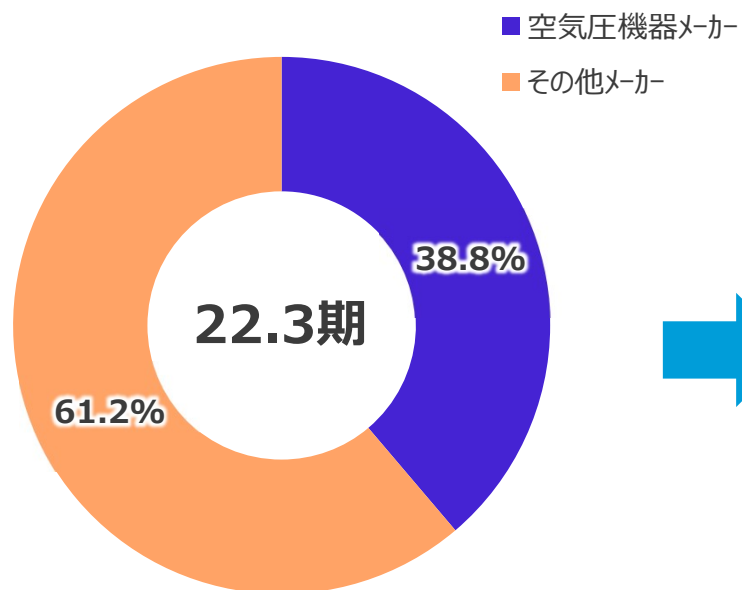
内外テック  
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス  
受託製造メーカー

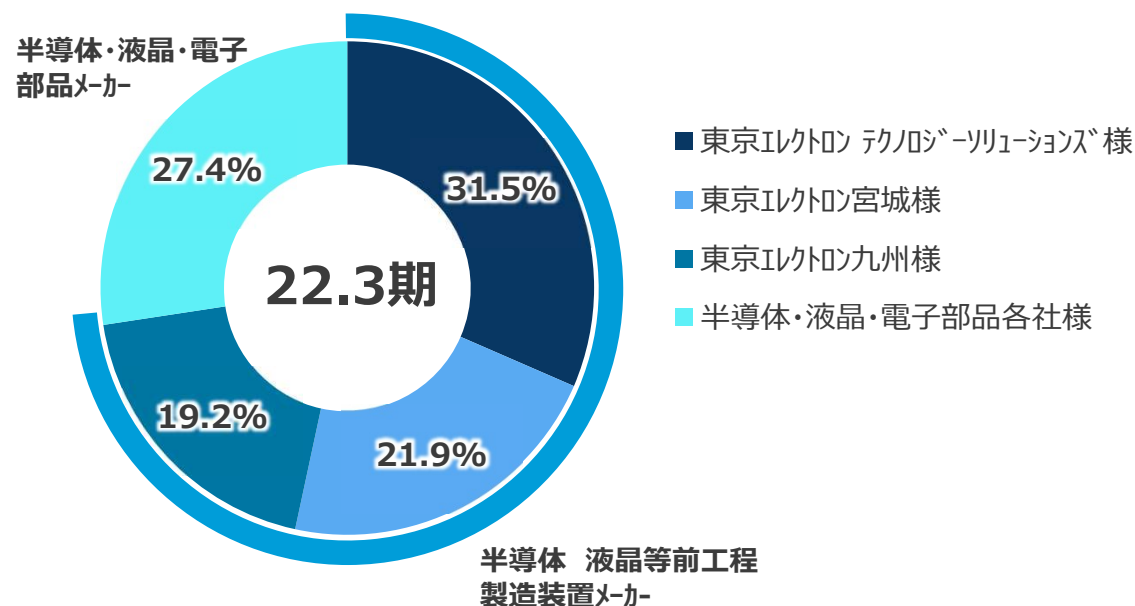
＝ モノづくりができるメーカー商社

## 【仕入先】



## 【販売先】

東京エレクトロン様グループで約7割



### 内外テック 仕入先・販売先

- 仕入先メーカー数 約1500社
  - 得意先数 約 950社
  - 主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、保守メンテナンス、装置改造
- 年間取扱いアイテム 約57,000件

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社